

平成 19 度 化学工学会 粒子・流体プロセス部会セミナー
「現象のシミュレーション解析と装置開発・プロセス操作への応用」

主催:化学工学会 粒子・流体プロセス部会

共催:化学工学会 関東支部

●日時:平成 20 年 2 月 6 日(水)9 時 30 分～19 時 30 分

●会場:東京工業大学 百年記念会館 フェライト会議室 (東急目黒線、大井町線、大岡山駅前)

交通アクセスおよび地図は以下をご覧ください。

<http://www.titech.ac.jp/access-and-campusmap/j/o-okayama-campus-j.html>

●プログラム

9:30-9:45 部会長挨拶 大阪大学 上山 惟一 氏

9:45-10:30 「大気圧熱プラズマによるナノ粒子合成と廃棄物処理のための数値解析」
東京工業大学 渡辺 隆行 氏

10:30-11:15 「気泡流のレーザー・光応用計測」

静岡大学 齋藤 隆之 氏

11:15-12:00 「有限差分法と界面追跡法による自由界面流れのシミュレーション」

埼玉大学 本間 俊司 氏

12:00-13:00 休憩

13:00-13:45 「ナノ粒子・流体運動解析に基づくナノプロセスへの応用」

東京大学 山口 由岐夫 氏

13:45-14:30 「高分子流体のレオロジーとその計算機シミュレーション」

京都大学 増淵 雄一 氏

14:30-15:15 「鉄鋼プロセスにおける混相流解析」

住友金属 高谷 幸司 氏

15:15-15:30 休憩

15:30-16:15 「詳細な化学反応を考慮した熱流体解析の適用事例」

シーディー・アダプロ・ジャパン 佐藤 昌弘 氏

16:15-17:00 「気泡流の多重スケール構造」

東京大学 高木 周 氏

17:30-19:30 懇親会

- 参加費(当日申し受けます):
- 部会員:7,000 円
 - 非部会員(化学工学会個人会員、法人会員)10,000 円
 - 化学工学非会員 12,000 円、学生会員 1,000 円

* 懇親会参加:4,000 円を別途申し受けます。

● 申込み先:下記まで E-mail にて以下申込事項をお知らせください。(締切:平成 20 年 1 月 25 日、定員 70 名)

東京工業大学大学院理工学研究科化学工学専攻 吉川史郎

E-mail syoshika@chemeng.titech.ac.jp Tel.&Fax 03-5734-3278

〒152-8550 東京都目黒区大岡山 2-12-1-S1-31

● 申込み 記入事項

- ・ご氏名、ご所属、E-mail アドレス、電話および FAX 番号
- ・会員種別
- ・懇親会のご出欠